課題番号 :F-17-AT-0126

利用形態 :機器利用

利用課題名(日本語) :ガスバリア性向上のための新規プラスチックフィルムへの被膜材料およびその成膜方法の

検討

Program Title (English) : Investigation of covering material and method of covering layer formation on new

plastic film for improvement of gas barrier properties.

利用者名(日本語) :津田紘一 Username (English) : K. Tsuda

所属名(日本語) :日東電工株式会社

Affiliation (English) : Nitto Denko Corporation

キーワード/Keyword :成膜・膜堆積、表面処理、原子層堆積装置[FlexAL]、電子ビーム真空蒸着装置

1. 概要(Summary)

包装用のプラスチックフィルムのガスバリア性を向上す るため、無機被膜を化学蒸着や物理蒸着により形成する ことが一般的に行われている。そのような中、非常に良質 な薄膜を均一かつコンフォーマルに形成できる ALD(原 子層堆積)による成膜が注目されている。良質な薄膜を形 成できる ALD 法であれば、被膜厚みが薄くても、高いガ スバリア性が得られるのではないかと考え、電子ビーム真 空蒸着とALDでSiO2被膜を形成し水蒸気バリア性を評 価した。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

原子層堆積装置[FlexAL]、電子ビーム真空蒸着装置 【実験方法】

成膜温度 120℃にて Plasma ALD 法により 0.5-30 nm の SiO₂ 膜をプラスチックフィルムに成膜した。また、成膜 レート 1.0 Å/s 成膜時間 100 s 圧力 3.6x10⁻⁵ Pa 電子ビーム電圧 9.6 kV で電子ビーム真空蒸着に より 10 nm の SiO2 膜をプラスチックフィルムに成膜した。 被膜の断面構造を FIB-TEM、水蒸気バリア性をカップ 法により評価した。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

一般的にスパッタ法、真空蒸着法などの物理成膜法と 比較し、ALD 法では膜の均一性・平坦性が高くなる傾向 がある。Fig. 1 にプラスチックフィルムへ厚み 10 nm の条 件で SiO₂ 膜を成膜した場合の FIB-TEM による断面観 察結果を示した。

ALDと真空蒸着いずれの方法でも狙いの 10 nm に近 い厚みの被膜が得られた。被膜の形状を比較するとALD で形成した被膜の方が平坦であることが分かる。

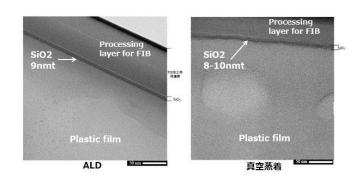


Fig. 1 Cross section images of SiO₂ coated plastic film observed by FIB-TEM.

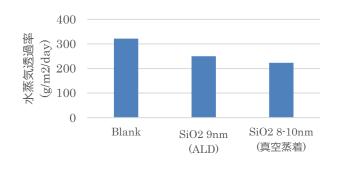


Fig. 2 water-vapor transmission ratio of SiO₂ coated and non-coated plastic film measured by cup method.

Fig. 2 にフィルム単体と 10 nm の SiO2 膜を成膜したフ ィルムの水蒸気透過率を示した。フィルム単体と比較して SiO₂ 膜を形成することにより、水蒸気透過率は低下する。 ALD と真空蒸着による成膜では水蒸気透過率に有意差 はなく、水蒸気バリア性向上の効果は同程度だと考えられ る。

<u>4. その他・特記事項(Others)</u> なし。

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation) なし。

6. 関連特許(Patent) なし。